

RAG 테스트 문서 (가짜 데이터) - 삼성전자 반도체 (Fictional)

Generated: 2025-12-25 05:53:38

목적: RAG(검색+생성) 테스트용으로 만들어진 '가짜' 문서입니다.

주의: 아래 수치/일정/제품명은 모두 예시이며 실제 사실이 아닙니다.

1) 가짜 개요(Fictional Overview)

- 회사: 삼성전자(반도체/DS) - 테스트용 가상 요약
- 가짜 프로젝트 코드명: Project BLUEWAFER
- 가짜 목표: 차세대 공정 전환 과정에서 수율(Yield) 개선 + 전력 효율 최적화
- 가짜 핵심 지표(KPI):
 - * 라인 A 수율: 82% -> 88% (가상 목표)
 - * 패키징 결함률: 1.6% -> 1.1% (가상 목표)

2) 가짜 제품/공정 메모(Fictional Notes)

- 가짜 공정명: SF-3X (예시)
- 가짜 메모리 제품: DRAM 'D-Alpha' (예시)
- 가짜 NAND 제품: V-NAND 'V9-F' (예시)
- 가짜 리스크: EUV 마스크 오염, CMP 불균일, 패키징 열(thermal) 스트레스

3) 가짜 운영 정보(Fictional Operations)

- 테스트용 RAG API Base URL 예시: <http://localhost:11434>
- 테스트용 기본 포트 예시: 11434
- 임베딩 모델 예시: nomic-embed-text
- 생성 모델 예시: gemma3:1b 또는 llama3.2:3b

4) 가짜 결론(Fictional Conclusion)

- 가장 큰 병목은 '패키징 열 스트레스'로 가정하며, 방열 설계 개선이 최우선이다(가상).
- 데이터 로깅 주기를 10분 단위로 통일하면 이상탐지 정확도가 개선될 수 있다(가상).

RAG 테스트 문서 (가짜 데이터) - 부록/용어/샘플 질문

Generated: 2025-12-25 05:53:38

A) 미니 용어집(Mini Glossary)

- Yield(수율): 양품 비율(예시 설명)
- EUV: 극자외선 노광(예시 설명)
- CMP: 화학기계연마(예시 설명)
- top_k: 벡터DB에서 검색해오는 청크 개수

B) 샘플 QA (정답이 문서에 '명시'되도록 구성)

Q1) 가짜 프로젝트 코드명은 무엇인가?

A1) Project BLUEWAFER

Q2) 문서에서 가정한 가장 큰 병목은 무엇인가?

A2) 패키징 열 스트레스

C) 테스트 팁

- 질문은 문서에 있는 문장/키워드를 그대로 묻는 형태가 가장 잘 동작합니다.
- 이미지 기반 PDF는 텍스트 추출이 어려울 수 있으며 OCR이 필요할 수 있습니다.